



平成23年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成22年8月9日

上場会社名 イノテック株式会社 上場取引所 東
 コード番号 9880 URL <http://www.innotech.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 澄田 誠 (TEL) 045 (474) 9000
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 酒井 慎二 配当支払開始予定日 —
 四半期報告書提出予定日 平成22年8月13日
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有・無
 四半期決算説明会開催の有無 : 有・無

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年3月期第1四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日）

(1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年3月期第1四半期	6,185	10.8	272	152.5	266	89.9	114	142.9
22年3月期第1四半期	5,582	△37.7	107	△76.9	140	△68.3	47	△72.1

	1株当たり 四半期純利益		潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益	
	円	銭	円	銭
23年3月期第1四半期	6	53	6	48
22年3月期第1四半期	2	35	2	34

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率	1株当たり純資産	
	百万円	円	百万円	円	%	円	銭
23年3月期第1四半期	27,752		21,164		75.3	1,195	19
22年3月期	27,863		21,091		74.8	1,191	79

(参考) 自己資本 23年3月期第1四半期 20,904百万円 22年3月期 20,844百万円

2. 配当の状況

	年間配当金									
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計					
	円	銭	円	銭	円	銭				
22年3月期	—		2	00	—		3	00	5	00
23年3月期	—									
23年3月期(予想)			4	00	—		6	00	10	00

(注) 当四半期における配当予想の修正有無 : 有・無

3. 平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日）

(%表示は、通期は対前期、第2四半期（累計）は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
第2四半期（累計）	12,800	14.9	570	322.4	550	144.0	220	—	12	58
通期	28,500	16.4	1,350	119.9	1,300	75.5	600	251.4	34	30

(注) 当四半期における業績予想の修正有無 : 有・無

4. その他（詳細は、[添付資料] P. 3「2. その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 : 有・無

(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 : 有・無

(注) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 会計基準等の改正に伴う変更 : 有・無

② ①以外の変更 : 有・無

(注) 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

23年3月期1Q	23,218,901株	22年3月期	23,218,901株
----------	-------------	--------	-------------

② 期末自己株式数

23年3月期1Q	5,728,728株	22年3月期	5,728,728株
----------	------------	--------	------------

③ 期中平均株式数（四半期累計）

23年3月期1Q	17,490,173株	22年3月期1Q	19,977,915株
----------	-------------	----------	-------------

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続を実施しています。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

1. 業績予想につきましては、平成22年5月13日に公表しました内容から変更しております。詳細につきましては平成22年8月9日付の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、[添付資料] P. 3「1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。なお、1株当たり当期純利益は、当第1四半期の期中平均株式数を基に算出しております。

○添付資料の目次

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	2
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	3
2. その他の情報	3
(1) 重要な子会社の異動の概要	3
(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要	3
(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書	6
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	7
(4) 継続企業の前提に関する注記	8
(5) セグメント情報	8
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	10

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期連結累計期間の我が国経済は、昨年からの各国政府の需要刺激策などによる海外経済の回復を背景に、緩やかな回復基調で推移しました。しかし一方で、ギリシャの財政危機に端を発した欧州の信用不安や米国、中国の景気の先行き懸念もあり、外需頼みの我が国の景気回復局面に、依然不透明感が残っております。

当社グループが参画いたします先端エレクトロニクス業界におきましては、昨年からの内外景気刺激策効果やそれに伴う景気回復を背景に液晶テレビやデジタルスチルカメラなどの民生機器市場が引き続き好調を維持しました。また、半導体メーカーの設備投資の一部に再開の動きが見られました。

このような状況のもと、当社グループにおける当第1四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高61億85百万円（前年同期比10.8%増）、営業利益2億72百万円（同152.5%増）、経常利益2億66百万円（同89.9%増）、四半期純利益1億14百万円（同142.9%増）となりました。

報告セグメント別の業績は次のとおりであります。

〔半導体設計事業〕

半導体設計事業は、当社グループの高度なエンジニアリング力を効果的に活用して高付加価値製商品及びサービスの提供に努め、既存顧客への販売強化と新規顧客開拓に注力し、積極的な営業活動を展開してまいりました。主力商品の米国ケイデンス社製半導体設計用（EDA）ソフトウェアは、新規顧客への拡販や長期契約の獲得により堅調に推移いたしました。大手半導体メーカーに採用されております自社製テストシステムRETSETは、顧客の設備投資再開の動きを受け、前年同期実績を大きく上回り売上に貢献いたしました。また、三栄ハイテックス株式会社のLSI設計受託ビジネスは、昨年実施した事業構造の見直しと顧客需要の持ち直しにより、前年同期実績を上回り収益に貢献いたしました。

その結果、当事業の売上高は22億4百万円、営業利益は1億60百万円となりました。

〔電子部品事業〕

電子部品事業は、デジタル家電やOA・FA市場の既存顧客を中心に当社のエンジニアリング力を生かし、高付加価値製商品及びサービスの提供、新規アプリケーションの開拓に努めてまいりました。ハードディスク部門は、市況の回復によりOA・FA市場においては出荷台数が増加しましたが、DVRを中心とするAV市場では競争が激化し売上が減少しました。デバイス部門は、デジタルテレビ向けHDMIチップやDVD向けレーザーダイオードドライブの出荷が大幅に増加し売上が大きく増やしました。アイティアアクセス株式会社の組み込みソフトウェア関連は、ライセンス販売についてOA機器や車載、デジタル家電向けが堅調に推移し、特にデジタルテレビ向けの大幅な増加、新規STB向けの一括受注により売上が大幅に増えました。

その結果、当事業の売上高は39億80百万円、営業利益は1億66百万円となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、277億52百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億11百万円減少しております。これは主に、現金及び預金が減少したためであります。

一方、負債は65億87百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億85百万円減少しております。これは主に、借入金が増加したためであります。

純資産は211億64百万円となり、前連結会計年度末に比べ73百万円増加しております。これは主に、四半期純利益を計上したためであります。この結果、自己資本比率は75.3%となり、前連結会計年度末に比べ0.5ポイント増加しております。

(キャッシュ・フローの状況)

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ1億22百万円減少し、22億2百万円となりました。これは、営業活動によって8億50百万円を得たものの、投資活動によって1億33百万円、財務活動によって8億45百万円を使用したためであります。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、8億50百万円の収入（同27.4%増）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益を2億60百万円計上したほか、仕入債務が3億91百万円、前受金が1億77百万円それぞれ増加したことなどにより資金を得たためであります。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、1億33百万円の支出（同59.3%増）となりました。これは主に、投資有価証券の取得に1億円使用したためであります。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、8億45百万円の支出（同57.2%増）となりました。これは主に、短期借入金が6億円減少し、長期借入金を2億円返済したためであります。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

当社は、平成22年5月13日に公表しました平成23年3月期の業績予想を修正いたしました。

詳細につきましては、平成22年8月9日付で別途公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

1. 簡便な会計処理

①固定資産の減価償却費の算定方法

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産につきましては、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定しております。

②たな卸資産の評価方法

当第1四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。

③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境や一時差異の発生状況等に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

2. 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

該当事項はありません。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

1. 資産除去債務に関する会計基準の適用

当第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用しております。

これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ190千円及び税金等調整前四半期純利益は5,936千円減少しております。

2. 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

当第1四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年3月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年3月10日）を適用しております。

なお、これにより損益に与える影響はありません。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成22年6月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,202,472	2,324,926
受取手形及び売掛金	7,413,294	7,436,641
商品及び製品	2,455,178	2,282,972
その他	3,279,704	3,371,352
貸倒引当金	△1,508	△1,373
流動資産合計	15,349,140	15,414,519
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	7,963,035	7,966,533
減価償却累計額	△3,321,051	△3,281,525
建物及び構築物（純額）	4,641,983	4,685,008
土地	5,687,498	5,687,498
その他	696,193	689,347
減価償却累計額	△464,434	△458,093
その他（純額）	231,758	231,253
有形固定資産合計	10,561,241	10,603,760
無形固定資産		
のれん	396,733	441,333
その他	72,142	77,254
無形固定資産合計	468,875	518,588
投資その他の資産		
投資有価証券	619,778	579,997
その他	905,748	916,939
貸倒引当金	△152,497	△169,862
投資その他の資産合計	1,373,028	1,327,074
固定資産合計	12,403,145	12,449,423
資産合計	27,752,286	27,863,942
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,114,858	1,707,281
短期借入金	1,750,000	2,550,000
未払法人税等	115,320	35,601
賞与引当金	23,461	—
役員賞与引当金	2,400	—
その他	2,108,232	2,039,577
流動負債合計	6,114,273	6,332,459
固定負債		
退職給付引当金	296,736	280,996
役員退職慰労引当金	26,257	23,200
その他	150,412	136,110
固定負債合計	473,406	440,307
負債合計	6,587,679	6,772,767

(単位：千円)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成22年6月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,517,159	10,517,159
資本剰余金	9,295,713	9,295,713
利益剰余金	3,329,868	3,268,130
自己株式	△2,266,268	△2,266,268
株主資本合計	20,876,474	20,814,736
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△3,185	28,165
繰延ヘッジ損益	14,666	△16,388
為替換算調整勘定	16,088	18,111
評価・換算差額等合計	27,570	29,889
新株予約権	69,412	69,412
少数株主持分	191,150	177,137
純資産合計	21,164,606	21,091,175
負債純資産合計	27,752,286	27,863,942

(2) 四半期連結損益計算書
(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日)
売上高	5,582,544	6,185,502
売上原価	4,389,801	4,825,099
売上総利益	1,192,743	1,360,402
販売費及び一般管理費	1,084,799	1,087,806
営業利益	107,943	272,596
営業外収益		
不動産賃貸料	126,511	61,053
その他	12,840	17,782
営業外収益合計	139,351	78,835
営業外費用		
不動産賃貸費用	87,656	71,941
その他	19,198	12,725
営業外費用合計	106,855	84,667
経常利益	140,440	266,764
特別利益		
投資有価証券売却益	—	694
貸倒引当金戻入額	—	546
特別利益合計	—	1,241
特別損失		
投資有価証券償還損	9,205	—
ゴルフ会員権売却損	2,682	—
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	5,745
その他	—	1,280
特別損失合計	11,887	7,026
税金等調整前四半期純利益	128,552	260,979
法人税等	75,059	132,525
少数株主損益調整前四半期純利益	—	128,453
少数株主利益	6,472	14,245
四半期純利益	47,020	114,208

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	128,552	260,979
減価償却費	89,342	65,869
のれん償却額	44,599	44,599
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,055	△546
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	7,607	15,739
受取利息及び受取配当金	△4,212	△4,204
支払利息	9,947	2,573
売上債権の増減額 (△は増加)	754,111	37,238
たな卸資産及び前渡金の増減額 (△は増加)	97,543	34,187
仕入債務の増減額 (△は減少)	△787,645	391,196
前受金の増減額 (△は減少)	209,965	177,314
その他	186,688	△163,134
小計	737,556	861,812
利息及び配当金の受取額	3,101	4,204
利息の支払額	△9,922	△2,918
法人税等の支払額	△63,260	△12,873
営業活動によるキャッシュ・フロー	667,474	850,224
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△6,739	△6,268
投資有価証券の取得による支出	—	△100,000
短期貸付けによる支出	△79,928	—
その他	2,832	△27,315
投資活動によるキャッシュ・フロー	△83,835	△133,584
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	300,000	△600,000
長期借入金の返済による支出	△308,400	△200,000
自己株式の取得による支出	△354,315	—
配当金の支払額	△173,892	△44,365
少数株主への配当金の支払額	△362	△232
その他	△935	△935
財務活動によるキャッシュ・フロー	△537,906	△845,534
現金及び現金同等物に係る換算差額	22,204	6,440
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	67,936	△122,453
現金及び現金同等物の期首残高	2,823,324	2,324,926
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,891,261	2,202,472

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

[事業の種類別セグメント情報]

前第1四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日）

	半導体設計 事業 (千円)	電子部品 事業 (千円)	計 (千円)	消去又は 全社 (千円)	連結 (千円)
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	2,375,559	3,206,985	5,582,544	—	5,582,544
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	9,342	—	9,342	△9,342	—
計	2,384,901	3,206,985	5,591,886	△9,342	5,582,544
営業利益	198,506	166,861	365,367	△257,423	107,943

(注) 1. 事業区分は内部管理上採用している区分によっております。

2. 各事業区分に属する主要な内容

半導体設計事業……………EDAソフトウェア、テストシステム、LSI受託設計開発

電子部品事業……………電子デバイス、ハードディスクドライブ、組み込みソフト開発

3. 事業区分の変更

事業区分の方法については、従来、内部管理上採用している区分によっておりますが、当第1四半期連結会計期間より一部について事業戦略の見直しとそれに伴う内部組織体制の変更を行ったため、内部管理上の組織変更に合わせて、従来「半導体設計事業」に含めておりましたボード開発販売を「電子部品事業」に含めることとしております。

なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報を、当第1四半期連結累計期間において用いた事業区分の方法により区分すると次のようになります。

前第1四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日）

	半導体設計 事業 (千円)	電子部品 事業 (千円)	計 (千円)	消去又は 全社 (千円)	連結 (千円)
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	3,404,862	5,554,839	8,959,701	—	8,959,701
(2) セグメント間の 内部売上高又は振替高	—	—	—	—	—
計	3,404,862	5,554,839	8,959,701	—	8,959,701
営業利益	522,126	327,555	849,682	△383,335	466,346

〔所在地別セグメント情報〕

前第1四半期連結累計期間（自平成21年4月1日至平成21年6月30日）

	日本 (千円)	アジア (千円)	計 (千円)	消去又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	4,687,665	894,878	5,582,544	—	5,582,544
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	847,017	31,748	878,766	△878,766	—
計	5,534,682	926,627	6,461,310	△878,766	5,582,544
営業利益	364,138	1,229	365,367	△257,423	107,943

- (注) 1. 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。
 2. 本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。
 アジア・・・シンガポール、中国、香港

〔海外売上高〕

前第1四半期連結累計期間（自平成21年4月1日至平成21年6月30日）

	アジア	ヨーロッパ	北米	計
I 海外売上高（千円）	1,112,744	179,136	4,629	1,296,509
II 連結売上高（千円）	—	—	—	5,582,544
III 連結売上高に占める海外 売上高の割合（%）	19.9	3.2	0.1	23.2

- (注) 1. 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。
 2. 各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりです。
 (1) アジア・・・マレーシア、台湾、中国、香港、シンガポール、韓国、タイ
 (2) ヨーロッパ・・・ハンガリー、フランス
 (3) 北米・・・アメリカ
 3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

[セグメント情報]

1. 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、親会社に製商品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う製商品・サービスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。また、連結子会社は、各社が取り扱う製商品・サービスについて、関連する親会社の事業本部と連携した事業活動を展開しております。

したがって、当社グループは、親会社の事業本部及び連結子会社を基礎とした製商品・サービス別のセグメントから構成されており、それらの経済的特徴等の類似性を考慮した「半導体設計事業」、「電子部品事業」の2つを報告セグメントとしております。

「半導体設計事業」は、主に半導体の設計工程に係る製商品・サービスを顧客に販売しており、半導体の設計及び検証用のソフトウェア、テストシステム、並びに設計サービスから構成されております。

「電子部品事業」は、主に顧客の最終製品である電気・電子機器に組み込まれる製商品(部品)を販売しており、ハードディスクドライブをはじめとする電子部品、CPUボードや組み込み用途向けソフトウェア等から構成されております。

2. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第1四半期連結累計期間（自平成22年4月1日 至平成22年6月30日）

(単位：千円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	半導体設計事業	電子部品事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	2,204,937	3,980,565	6,185,502	—	6,185,502
セグメント間の内部 売上高又は振替高	10,512	—	10,512	△10,512	—
計	2,215,449	3,980,565	6,196,014	△10,512	6,185,502
セグメント利益	160,862	166,680	327,543	△54,946	272,596

(注) 1. セグメント利益の調整額△54,946千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△54,305千円及び棚卸資産の調整額△641千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。

(追加情報)

当第1四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年3月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日)を適用しております。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。